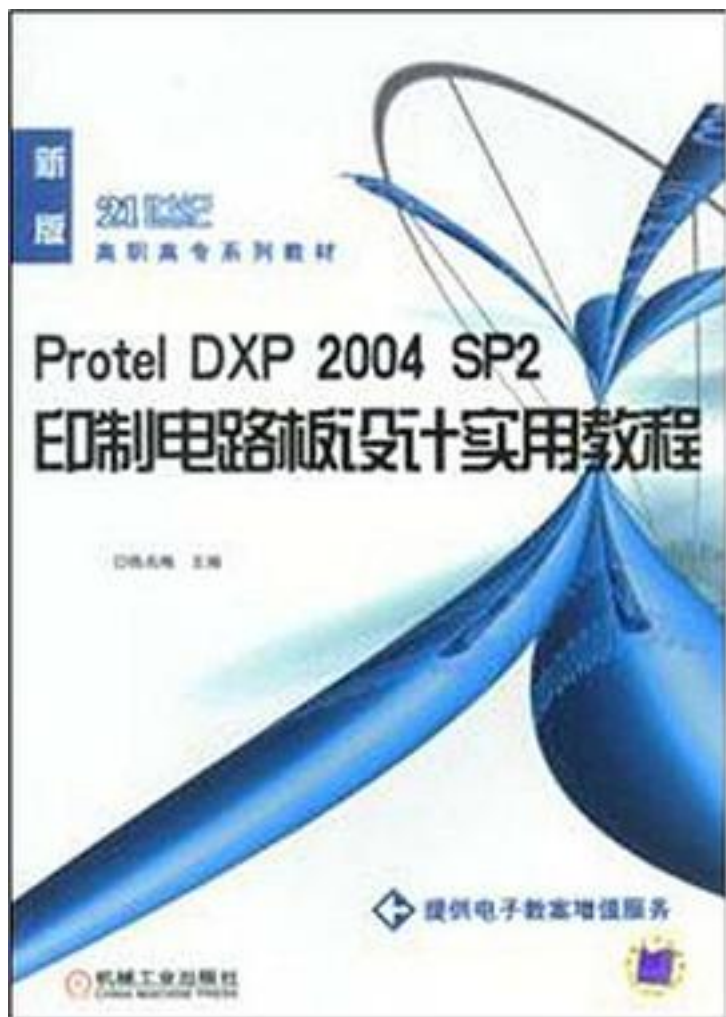


# Protel DXP2004SP2印制电路板设计实用教程



[Protel DXP2004SP2印制电路板设计实用教程\\_下载链接1](#)

著者:陈兆梅

出版者:机械工业

出版时间:2008-2

装帧:

isbn:9787111234111

《21世纪高职高专系列教材·Protel

DXP2004SP2印制电路板设计实用教程(新版)》介绍了使用DXP 2004 SP2进行印制电路板设计应具备的基础知识,包括原理图设计、印制电路板设计、集成库的创建以及仿真技术。《21世纪高职高专系列教材·Protel DXP2004SP2印制电路板设计实用教程(新版)》充分考虑了高职高专学生的知识结构,以培养学生正确的设计思路、提高学生解决实际问题的能力为目标,合理选择内容和案例,并安排了18个针对性很强的“上机与指导”。

作者介绍:

目录: 出版说明前言第1章 Protel DXP 2004 SP2概述 1.1 软件简介 1.1.1 软件发展历史 1.1.2 软件新特性 1.2 软件的系统配置要求、软件安装及运行 1.2.1 软件安装的系统要求 1.2.2 软件安装及运行 1.3 文档组织结构与文档管理 1.3.1 文档组织结构 1.3.2 文档创建 1.3.3 文档保存第2章 原理图制作基础 2.1 制作第一个原理图——单管共射放大电路的制作 2.1.1 新建原理图文件 2.1.2 工作界面与图纸的设置 2.1.3 元件库的加载和使用 2.1.4 单管共射放大电路的制作 2.2 图形对象的放置和属性修改 2.2.1 元器件的放置和属性修改 2.2.2 导线的放置和属性修改 2.2.3 手工节点的放置和属性修改 2.2.4 电源端口的放置和属性修改 2.2.5 文本的放置和属性修改 2.2.6 文本框架的放置和属性修改 2.2.7 上机与指导1 2.3 网络表 2.3.1 元器件封装方式的添加 2.3.2 网络的概念及网络表的生成 2.3.3 上机与指导2 2.4 多单元元器件的使用——半加器电路的制作 2.4.1 多单元元器件的放置 2.4.2 半加器电路的制作 2.4.3 上机与指导3 2.5 原理图常用操作 2.5.1 菜单 2.5.2 工具条第3章 印制电路板制作基础 3.1 准备知识 3.1.1 印制电路板简介 3.1.2 印制电路板的布局原则 3.1.3 印制电路板的布线原则 3.1.4 PCB的抗干扰措施 3.1.5 元器件实物、元器件符号和元器件封装方式识别 3.1.6 插孔式元器件和表面封装元器件识别 3.2 手工布线制作单面板 3.2.1 案例准备 3.2.2 PCB界面介绍、基本设置以及层的知识 3.2.3 将原理图内容同步到PCB 3.2.4 元器件布局 3.2.5 手工布线 3.2.6 上机与指导4 3.3 自动布线制作单面板 3.3.1 案例准备 3.3.2 画禁止布线区 3.3.3 布线设置 3.3.4 自动布线 3.3.5 PCB的3D展示 3.3.6 上机与指导5 3.4 自动布线制作双面板 3.4.1 案例准备 3.4.2 利用向导创建PCB文件 3.4.3 将原理图内容同步到PCB 3.4.4 布线设置 3.4.5 自动布线 3.4.6 PCB的3D展示 3.4.7 上机与指导6 3.5 印制电路板常用操作 3.5.1 菜单 3.5.2 工具条第4章 原理图元器件的制作 4.1 原理图元器件编辑器 4.1.1 打开成品库文件 4.1.2 新建原理图元件库文件 4.2 分立元器件的制作 4.2.1 制作准备 4.2.2 分析成品库内的电阻 4.2.3 网格设置 4.2.4 电阻符号的制作过程 4.2.5 上机与指导7 4.3 多单元元器件的制作 4.3.1 制作准备 4.3.2 分析成品库内的MC74HCOOAN 4.3.3 MC74HCOOAN的制作过程 4.3.4 上机与指导8 4.4 原理图元器件常用操作 4.4.1 菜单 4.4.2 工具条第5章 封装方式库的制作 5.1 手工制作元器件的封装方式 5.1.1 封装方式编辑器 5.1.2 手工制作封装方式的过程 5.1.3 上机与指导9 5.2 利用向导制作封装方式 5.2.1 制作过程 5.2.2 上机与指导10 5.3 封装方式库常用操作 5.3.1 菜单 5.3.2 工具条第6章 集成库的生成和维护 6.1 集成库的生成 6.1.1 集成库简介 6.1.2 集成库的加载与卸载 6.1.3 元器件搜索 6.1.4 生成集成库 6.2 集成库的维护 6.3 上机与指导11第7章 原理图与印制电路板进阶 7.1 原理图进阶 7.1.1 原理图的电连接性 7.1.2 上机与指导12 7.1.3 总线的使用 7.1.4 上机与指导13 7.1.5 原理图图形对象属性修改技巧 7.1.6 原理图与PCB之间的交叉追踪 7.1.7 元器件自动编号 7.1.8 在原理图预置PCB设计规则 7.1.9 原理图编译与电气规则检查 7.1.10 上机与指导14 7.2 印制电路板进阶 7.2.1 元器件布局 7.2.2 布线 7.2.3 制作PCB的后期处理 7.2.4 设计规则的检查 7.2.5 PCB面板 7.3 PCB工程报表输出 7.3.1 元器件采购清单 7.3.2 光绘文件和钻孔文件 7.3.3 装配文件 7.3.4 上机与指导15第8章 仿真 8.1 仿真的意义及类型 8.1.1 仿真的意义 8.1.2 仿真类型 8.2 仿真举例 8.2.1 静态工作点分析、瞬态分析和傅里叶分析 8.2.2 上机与指导16 8.2.3 参数扫描 8.2.4 交流小信号分析 8.2.5 DC扫描 8.2.6 上机与指导17 8.3 仿真常见错误 8.3.1 仿真常见错误案例分析 8.3.2 上机与指导18第9章 印制电路板综合设计 9.1 设计印制电路板的总体思路 9.2 BTL功放电路的印制电路板设计 9.2.1 资料分析 9.2.2

制作过程 9.2.3 电气规则检查 9.2.4 报表输出、装配图以及光绘文件输出参考文献  
· · · · · (收起)

[Protel DXP2004SP2印制电路板设计实用教程\\_下载链接1](#)

标签

评论

-----  
[Protel DXP2004SP2印制电路板设计实用教程\\_下载链接1](#)

书评

-----  
[Protel DXP2004SP2印制电路板设计实用教程\\_下载链接1](#)